

軟磁性モールド材料

射出成形用
EMCコンパウンド

成形品イメージ



概要

射出成形用EMCコンパウンドは、戸田工業のソフトフェライト粉末や軟磁性メタル粉末をPPSやPAなどの樹脂と混合させた軟磁性モールド材です。優れた磁気特性と射出成形性を両立しており、複雑な形状のインダクタコアや構造体、各種EMC機能(漏洩磁界低減・磁気シールド)を有した部品や筐体の設計が可能です。

特徴

- 1 高透磁率**
磁性粉末を高充填させることができるため、優れた透磁率特性が得られます。
- 2 優れた射出成形性**
樹脂複合化に適した特性を有する磁性粉末を使用しており、成形性に優れています。
- 3 ニーズに合わせた樹脂選定**
車載用途に使われるエンブラやスーパーエンブラなど各種樹脂のコンパウンドも可能です。

製品情報

【代表製品の特性】

銘柄	樹脂	磁性粉 (フィラー)	成形密度	流動性MFR	透磁率 μ' at 10MHz	磁束密度B	荷重たわみ温度*	曲げ強度	衝撃強度	線膨張係数
			ASTM-D792 (g/cm ³)	ASTM-D1238 (g/10min)	- (-)	- (mT)	ISO 75-2 (°C)	ASTM-D790 (MPa)	ASTM-D256 (kJ/m ²)	JIS K 7197 ($\times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$)
SP-I247AEN	PA12	鉄粉	5.0	400 [270°C/5kgf]	10.5	1,220	112	60	9	6.6
MC100LK31	PA6	Mn-Mg-Zn フェライト	3.3	55 [270°C/10kgf]	16.5	160	172	120	6	4.1
SP-N736	PPS	Ni-Zn フェライト	3.6	40 [300°C/5kgf]	16.4	250	215	95	5	2.2

*方向：フラットワイス、曲げ応力：1.80MPa

用途

- インダクタコア、構造体
- 電磁波吸収・磁気シールド・ノイズ抑制用途の部品・筐体

